

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司證券之邀請、要約或其一部份。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL
CORPORATION**

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 981)

海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司 (Semiconductor Manufacturing International Corporation, 「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中芯國際集成電路製造有限公司首次公開發行人民幣普通股 (A 股) 股票並在科創板上市網上路演公告》，僅供參閱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

高永崗

執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書

中國上海

二零二零年七月三日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學（*董事長*）

趙海軍（*聯合首席執行官*）

梁孟松（*聯合首席執行官*）

高永崗（*首席財務官兼聯席公司秘書*）

非執行董事

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

William Tudor Brown

叢京生

劉遵義

范仁達

楊光磊

* *僅供識別*

中芯国际集成电路制造有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年6月19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1278号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“联席主承销商”或“联席保荐机构”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席主承销商”或“联席保荐机构”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）；国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券和摩根士丹利华鑫

证券统称“联席主承销商”)。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股份全部为新股，初始发行股票数量为168,562.00万股，约占发行后总股本的23.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至193,846.30万股，约占发行后总股本26.23%（超额配售选择权全额行使后）。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的初始战略配售的股票总量拟设定为 84,281.00 万股，占初始发行数量的 50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 43.48%。其中本次联席保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）、中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）跟投的股份数量预计分别为本次公开发行股份的 2%，即 3,371.24 万股。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行量为 67,424.80 万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 80%，约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 61.54%，回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量 16,856.20 万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的 20%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 42,140.50 万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 38.46%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020年7月6日（T-1日）9:00-12:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：	中芯国际集成电路制造有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：	海通证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：	国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：	国开证券股份有限公司
联席主承销商：	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2020年7月3日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

Semiconductor Manufacturing International Corporation

中芯国际集成电路制造有限公司



2020 年 7 月 3 日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2020年7月3日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2020年7月3日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 7 月 3 日

（此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2020年7月3日

(此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页)

联席主承销商：国开证券股份有限公司



2020年7月3日

(此页无正文，为《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页)

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2020 年 7 月 3 日